(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2005 年10 月27 日 (27.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/101486 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/68, 21/301

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/007116

(22) 国際出願日: 2005 年4 月13 日 (13.04.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-119567 2004 年4 月14 日 (14.04.2004) JP
特願2004-133069 2004 年4 月28 日 (28.04.2004) JP
特願2004-155595 2004 年5 月26 日 (26.05.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 辻本正樹 (TSUJIMOTO, Masaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 吉岡孝久 (YOSHIOKA, Takahisa) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小林賢治 (KOBAYASHI, Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

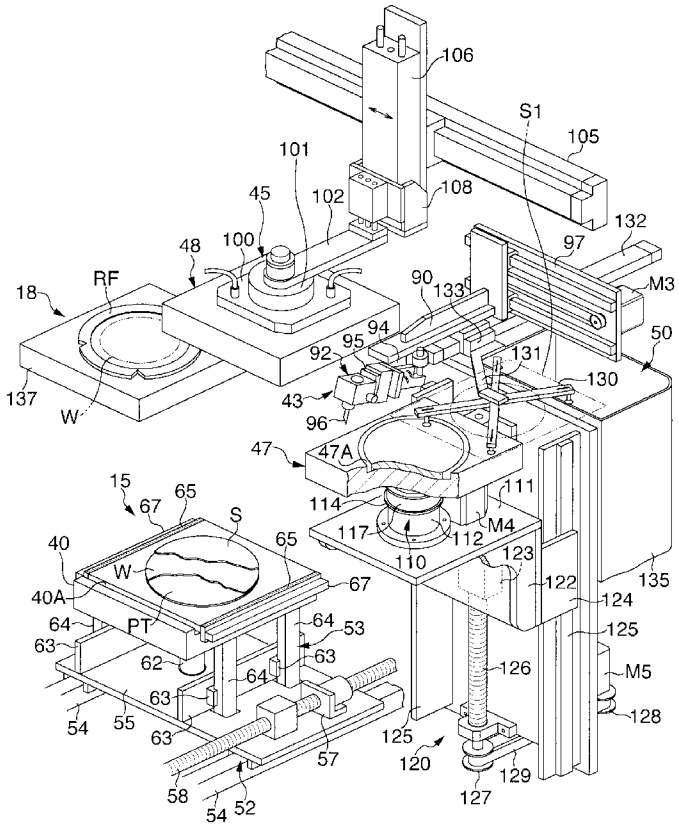
(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: WAFER PROCESSING DEVICE AND WAFER PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: ウエハ処理装置及びウエハ処理方法



(57) Abstract: A sticking device (15) is constructed from a sticking table (40) supporting a semiconductor wafer (W), a sticking unit (41) for sticking a heat-sensitive adhesive sheet (S), and a cutter (96) for cutting the adhesive sheet crosswise and peripherally for each semiconductor wafer. The table comprises the first sticking table (40) controlled to a first temperature for temporarily sticking the adhesive sheet (S) to the wafer (W), an outer periphery cutting table (47) controlled to a second temperature which lowers the stickiness of the adhesive sheet for cutting the latter, and a connecting table (48) controlled to a third temperature for completely sticking the adhesive sheet (S) to the wafer (W).

(57) 要約: 半導体ウエハＷを支持する貼付テーブル４０と、感熱性の接着シートＳを貼付する貼付ユニット４１と、接着シートを半導体ウエハ毎に幅方向及び周方向に切断するカッター９６とを備えて貼付装置１５が構成されている。テーブルは、接着シートＳをウエハＷに仮着する第１の温度に制御された貼付テーブル４０と、接着シートの粘性を低下させる第２の温度に制御されて当該接着テープを周方向に切断する外周カット用テーブル４７と、接着シートＳをウエハＷに完全に接着させる第３の温度に制御された接着用テーブル４８とにより構成されている。

WO 2005/101486 A1

ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。